

Quel four pour quelle application ?

Les deux doubles pages qui suivent donnent un aperçu des fours qui peuvent être utilisés pour les processus de fabrication additive respectifs. Cette double page décrit les fours qui peuvent être utilisés pour les procédés dans lesquels aucune substance inflammable n'est générée.

Type d'atmosphère

Air

Température maximale

300 °C

850 °C

1280 °C

650 °C

650 °C

Exigence teneur en oxygène

21 %

21 %

21 %

1 %

0,10 %

Vide

-

-

-

-

-

Gaz de processus combustible

-

-

-

-

-

Type de four

TR, page 60
KTR, page 62

NA, page 42
SAL, page 48

LH, page 30
NW, page 34
N, page 36
KTR, page 62

NA .. I, page 47

NA .. SI, page 47

Energie du four

Électrique



Etuve de séchage KTR 2000 pour polymérisation après impression 3D



Four chambre LH 60/12 avec caisson de mise sous gaz pour les traitements thermiques sous atmosphère au gaz protecteur



Four chambre à convection forcée NA 250/45 pour les traitements thermiques à l'air

Gaz de processus

Vide

Gaz de processus			Vide	
1100 °C	1150 °C	2400 °C	≤ 600 °C	≥ 600 °C
0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
-	-	≤ 10 ⁻⁵ mbar	≤ 10 ⁻⁵ mbar	≤ 10 ⁻⁵ mbar
-	x	x	x	x
Avec caisson de mise sous gaz LH, page 30 NW, page 34 N, page 36 NA*, page 42 SAL*, page 48	NR(A), page 14 SR(A), page 21 LBR(A), page 20	VHT, page 22 LBVHT, page 27	NR(A), page 14 SR(A), page 21 LBR(A), page 20	VHT, page 22 LBVHT, page 27

Électrique



SAL 250/65

Fours moufle étanche à paroi froide VHT 100/12-MO pour les applications sous vide poussé

Installation de revenu semi-automatique avec four moufle NR 50/11 et bac de trempe à l'eau sur rails